



Forum Leichtbau für die Produktion – Messerundgang zur Bondexpo

Internationale Fachmesse für Klebtechnologie am Mittwoch, den 07.10.2015



Bondexpo – Richtungsweisender Branchentreff der Klebtechnologie

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie ein zum Messerundgang auf der Bondexpo – dem weltweit führenden Branchen- und Anwendertreff wenn es um die Prozesskette Fügen/Verbinden durch Kleben, Vergießen, Dichten und Schäumen geht. Der Themenkomplex Verbinden und Fügen neuer Materialien jetzt und in der Zukunft stellt eine echte „klebtechnische Herausforderung“ dar. Denn Leichtbau ist nicht nur ein Thema in Fahrzeugen, sondern auch in Apparaten und Geräten. In künftigen Materialien und Materialkombinationen sowie Hybridlösungen finden sich Ratio- und Ressourcen-Potentiale, die sich nur mit dem Einsatz neuer Klebstoffe realisieren lassen.

Die Fachmesse vermittelt den Entwicklungsstand und das Know-how zwischen Forschung und Entwicklung sowie Anwendung und Applikation und weist Wege in die Zukunft der Kleb-, Dämm- Schäum-, Dicht- und Vergießtechnologie. Im Rahmen unseres Messerundgangs besuchen wir innovative sowie hochkompetente Aussteller und bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit den jeweiligen Experten vor Ort über Technologien, Anwendungen und Perspektiven auszutauschen.

Sie erhalten einen kostenlosen Zutritt zur Messe und haben zusätzlich die Möglichkeit, die parallel stattfindende Motek – Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung - zu besuchen.

Treffpunkt:

am 07.10.2015 um 10:00 Uhr in der Region Stuttgart Lounge, Eingang Ost der Messe Stuttgart



Ablauf:

Moderation der Führung: Dr. Astrid Wagner

- 10:00 Uhr Treffen mit kurzer Begrüßung
- 10:25 Uhr Beginn des Bondexpo-Messerundgangs, Halle 9
- 10:40 Uhr Besuch der Kübler und Dostech GmbH
- 11:10 Uhr Besuch der Rampf Produktion Systems GmbH & Co. KG
- 11:30 Uhr Besuch der SCA Schucker GmbH & Co. KG
- 11:50 Uhr Besuch der bdtronic GmbH
- 12:10 Uhr Besuch der APM Technica AG
- 12:30 Uhr Besuch der Walther Spritz- und Lackiersysteme GmbH
- 13:15 Uhr Ende des Bondexpo-Messerundgangs an der Region Stuttgart Lounge

Sind Sie an der Teilnahme zum Messerundgang interessiert, dann melden Sie sich bitte mit vollständigem Namen und Firmenbezeichnung bei der AFBW, Frau Stefanie Koch, per Mail unter stefanie.koch@afbw.eu an. **Anmeldeschluss ist der 01. Oktober 2015.**

Weitere Informationen und Termine zum „Forum Leichtbau für die Produktion“ finden Sie auch unter: <http://www.vdc-fellbach.de/netzwerk/arbeitsgruppen/iak-leichtbau>.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Möller
AFBW

Dr. Christoph Runde
VDC Fellbach

Volker Schiek
Landesnetzwerk
Mechatronik BW

Dr. Thomas Stehle
IfW, Universität Stuttgart

Dr. Marco Schneider
Fraunhofer IPA

Dr. Martin Zagermann
Wirtschaftsförderung Region
Stuttgart GmbH

Markus Niedermaier
Manufuture-BW